



电子化工新材料产业联盟

简 报

2023 年第 6 期

电子化工新材料产业联盟秘书处编印

地址：北京市朝阳区胜古中路 2 号院金基业大厦 716 室电话：010-64476901/64498802

邮箱：cem@ecmia.org.cn

传真：010-64455623

联盟网站：www.ecmr.org.cn

微信公众号：电子化工新材料产业联盟

目 录

【联盟活动】

2023·中国显示行业供应链技术和市场对接交流会在大连隆重召开

【行业要闻】

奥松半导体 8 英寸 MEMS 特色芯片 IDM 产业基地项目在重庆开工

积塔半导体 12 英寸产线顺利通线

JDI 宣布与惠科战略联盟最终协议签订延长至 9 月底

455 亿元！日本投资公司将收购光刻胶巨头 JSR

中巨芯科创板 IPO 注册申请获证监会同意批复

【统计数据】

SEMI：2022 年全球半导体材料市场销售额达到创纪录的 730 亿美元

机构：全球智能手机 OLED 面板使用率已达 49%

【财报速递】

台积电 5 月营收月增 19.4% 创 4 个月新高记录

联电 5 月收入 188 亿元新台币 同比下降 23%

【产业分析】

机构：先进半导体封装将是新地缘政治战场

【联盟活动】

2023·中国显示行业供应链技术和市场对接交流会在大连隆重召开

7月11日，由中国光学光电子行业协会液晶分会、中国电子材料行业协会和电子化工新材料产业联盟共同主办，大连市工业和信息化局、大连金普新区管理委员会、大连普湾经济区管理委员会和大连市半导体行业协会联合协办的“2023·中国显示行业供应链技术和市场对接交流会”在大连隆重召开。

大会开幕式由中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清主持，主旨报告环节由中国电子材料行业协会常务副秘书长鲁瑾主持。中国科学院欧阳钟灿院士，工业和信息化部电子信息司金磊处长，大连市人民政府党组成员、大连太平湾合作创新区党委书记李奇，大连金普新区党工委委员、管委会副主任赵玉鹏出席大会分别致辞或讲话。

中国电子材料行业协会高级顾问袁桐女士代表主办方首先致辞，她提到，作为先进制造和新一代电子信息领域的核心基础产业，近年来，全球显示行业快速发展。尽管2022年行业遭遇前所未有的挑战，但中国显示行业展现出强大韧性，国内与之配套的材料业和装备业也取得了显著进步，技术创新能力不断提升。细分产品来看，基板玻璃产业整体步入供应链的中高端；偏光片在电视、手机、PC等领域应用已具有一定优势，市场占有率快速提升；液晶材料国产化率已超过70%；以自主研发创新为主的国内OLED材料生产商逐步进入国内面板厂商供应体系；溅射靶材多品种实现大批量供应；湿化学品与电子气体，除个别产品外，均已实现了国产产品的稳定供应，特别是电子气体，整体国产化率已提高到75%。

综合来看，行业整体竞争力取得了稳步提升。设备方面，模组设备近年来发展迅速，清洗和蚀刻也取得了一系列进展。

欧阳钟灿院士在致辞中指出，作为信息交互的重要端口，显示产业已发展成为新一代信息技术的先导性支柱产业。我国新型显示产业经历多年发展，产业不断升级，目前已成为全球显示产业的重要一极，在显示器件的产能、出口、产值方面都位列全球前茅。面向未来，他表示，新业态新技术不断涌现，我们要践行习近平总书记对自主创新要求，新型显示产业将持续增强。中国显示产业庞大的规模，也将为产业链、供应链发展提供巨大的市场。他强调，产业链、供应链的安全稳定，需要显示面板龙头企业扮演好“链主”角色，以市场化手段带动上游企业发展，在关键材料、核心设备和零组件方面开展多层次生态合作。

金磊处长在讲话中表示，工信部电子司高度重视我国新型显示行业全面发展，会同有关方面在规划布局、技术创新、标准制定、国际合作等领域开了大量工作，今后将继续按照党中央国务院的有关决策部署，加快建设新型现代化产业体系，推动产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展，重点做好以下工作：

一是加强统筹规划和顶层设计，加快发布实施显示行业的专项政策。二是要继续支持创新攻关和技术突破，三是要加快产业协同和上下游对接，支持材料、设备等配套产业的成果导入，四是要继续深化国际交流和开放合作。

李奇书记在讲话中指出，大连市是中国北方重要的工业城市，造船、石化、装备制造等产业具有雄厚的实力，电子信息产业具有一定的产业规模和基础。他表示，近年来，在大力发展战略性新兴产业，推动工业结构调整和经济转型发展的过程中，大连市始终把电子信息产业作为重要的突破口，积极推动发展。希望与行业专家、领军企业更多交流合作，共同促进大连市电子信息产业高质量发展。

赵玉鹏副主任在致辞中表示，大连市拥有中国科学院大连化物所、大连理工大学等知名高校和科研机构，可以为新型显示行业提供有利的基础研究和应用研究的支撑。金普新区拥有较为完整的石油化工、电子信息产业链，可以为新型显示产业提供上游设备、材料配套等供应。金普新区是东北最早开放的热土，拥有自贸区、自创区，以及对日韩的开放先发优势，可以为新型显示行业提供广阔的平台。

主旨演讲环节，大连理工大学、中国科学院院士彭孝军、中国电子信息产业发展研究院显示领域首席研究员耿怡、中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部主任郑玉善、维信诺科技股份有限公司供应链中心总经理刘传珍、昆山龙腾光电股份有限公司供应链管理高级总监龚正梅、深圳市联得自动化装备股份有限公司总监王建太、深圳莱宝高科技股份有限公司 TFT 事业部总经理乔传兴、明基材料有限公司行销总监吴建宏、大连科利德半导体材料股份有限公司项目经理唐瑛楠、安徽越好电子装备有限公司总经理沈玮徽、吉林奥来德光电材料股份有限公司副总经理马晓宇、苏州光斯奥光电科技有限公司研发中心总监姚自强、大连华邦化学有限公司总经理侯鹏等显示产业链的知名专家和企业家人，围绕显示产业现状、走势、显示技术发展趋势以及显示材料装备等配套环节的发展现状、机遇、挑战及未来路径等主题做了精彩分享。

新型显示产业是信息时代的基础性战略性产业，对推进供给侧结构性改革，打造竞争新优势，实现制造业高质量发展具有重要的战略意义。经过十多年的跨越式发展，我国已进入新型显示产业高质量发展阶段。但与此同时，我国也面临更多的逆风逆水的外部环境以及巨大的内外部风险和挑战。全球变局下，重塑显示产业生态新价值刻不容缓。要实现全产业高质量发展必须有相关装备和材料的

配套支撑，因此加快完善安全稳定的供应链生态是当前我国显示产业发展的重要任务。大会作为新型显示领域前沿技术和先进材料、设备的风向标和产业链上下游交流合作的平台，已成功举办多届。

本次会议汇聚了中国科学院、清华大学、北京大学、大连理工大学、华星光电、天马微电子、维信诺、惠科光电、龙腾光电、默克光电、集创北方、晶洲装备、诚志永华、欣奕华、八亿时空、格林达、兴福电子、奥来德、柔显科技、科利德等国内显示产业专家学者及上下游企业精英，深度探讨了显示行业发展先机，分析了新格局下显示产业链上下游的发展新思路，深化了企业交流，对加强产业链和市场对接，产业链技术创新的需求对接，产业链各环节不同资源的对接，对重塑显示产业生态新价值和推动我国新型显示产业稳步健康发展起到了良好的促进作用。

【行业要闻】

奥松半导体 8 英寸 MEMS 特色芯片 IDM 产业基地项目在重庆开工

6 月 28 日上午，奥松半导体 8 英寸 MEMS 特色芯片 IDM 产业基地项目在西部（重庆）科学城举行开工奠基仪式。

据介绍，项目总投资 35 亿元，用地约 230 亩，包含 8 英寸 CMOS+MEMS 特色传感器芯片量产线、8 英寸 MEMS 特色晶圆快速研发线、智能传感器创新研发中心、车规级传感器可靠性检测中心、产学研科研中心及奥松半导体研发办公大楼等建设项目，技术能力覆盖 CMOS+MEMS 特色工艺，可全面开展表面硅、体硅以及新工艺、新器件、新系统的研发和量产；具有 MEMS 压阻、压电、硅光、磁材料、MOX、微流控等相关工艺的研发和量产设备，大幅提升产品研发的成功率，可实现各类 MEMS 半导体传感器产品从研发到量产的无缝衔接。

积塔半导体 12 英寸产线顺利通线

积塔半导体 12 英寸汽车芯片先导线顺利建成通线，标志着积塔 12 英寸汽车芯片项目取得重大进展，是积塔半导体实现 12 吋汽车芯片战略的重要里程碑。

12 英寸 BCD 产品于 2023 年 2 月正式投片，2023 年 6 月 2 日流片完成，元器件电性(WAT)测试结果全部达标。充分验证了积塔半导体 12 英寸特色工艺产线已具备量产标准，对积塔未来的工艺技术提升、产品开拓、产线扩建具有重要意义。

积塔 12 英寸汽车芯片工艺线项目，着力 90nm 到 40nm 车规级微处理器(MCU)、模拟 IC、CIS 等高端芯片制造，是打造全国领先的汽车芯片制造基地的重要载体。项目将填补公司在 12 英寸工艺半导体芯片制造能力的空白，新起点，新征程，今后，积塔半导体将继续深耕车规芯片制造平台，全力推进车规芯片生产线项目建设，为建成国内一流汽车芯片制造基地贡献力量！

JDI 宣布与惠科战略联盟最终协议签订延长至 9 月底

6 月 30 日消息，JDI 与惠科的战略联盟最终协议将从 6 月底移至 9 月底签订。日本液晶显示器公司 JDI (JapanDisplay) 30 日宣布，将于 9 月底前与中国显示器制造商惠科 (HKC) 达成战略联盟最终协议。

JDI 表示，“由于需要广泛而详细的安排，我们将根据双方公司的协议延长磋商期。预计推迟对盈利的影响很小。”

455 亿元！日本投资公司将收购光刻胶巨头 JSR

据日本共同社 26 日晚间报道，日本半导体材料巨头 JSR 于 26 日宣布，将被日本政府出资的“产业革新投资机构”(下称革新机构)收购。革新机构将实施逾 9000 亿日元(约合人民币 455 亿元)的要约收购(TOB)，JSR 将从东京证券交易所最高一级“PRIME”市场摘牌退市。

中巨芯科创板 IPO 注册申请获证监会同意批复

据证监会网站消息，证监会收到上交所报送的关于中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及公司注册申请文件。

根据有关规定，经审阅上交所审核意见及公司注册申请文件，证监会同意该公司首次公开发行股票的注册申请。该公司本次发行股票应严格按照报送上交所

的招股说明书和发行承销方案实施。批复自同意注册之日起 12 个月内有效。自同意注册之日起至本次股票发行结束前，该公司如发生重大事项，应及时报告上交所并按有关规定处理。

【统计数据】

SEMI：2022 年全球半导体材料市场销售额达到创纪录的 730 亿美元

美国加州时间 2023 年 6 月 13 日，SEMI 今天在其《材料市场数据订阅》（Materials Market Data Subscription, MMDS）报告中称，2022 年全球半导体材料市场销售额增长 8.9%，达到 727 亿美元，超过了 2021 年创下的 668 亿美元的前一市场高点。

2022 年，晶圆制造材料和封装材料的销售额分别达到 447 亿美元和 280 亿美元，分别增长 10.5% 和 6.3%。硅、电子气体和光掩模领域在晶圆制造材料市场表现出最强劲的增长，而有机衬底领域在很大程度上推动了封装材料市场的增长。

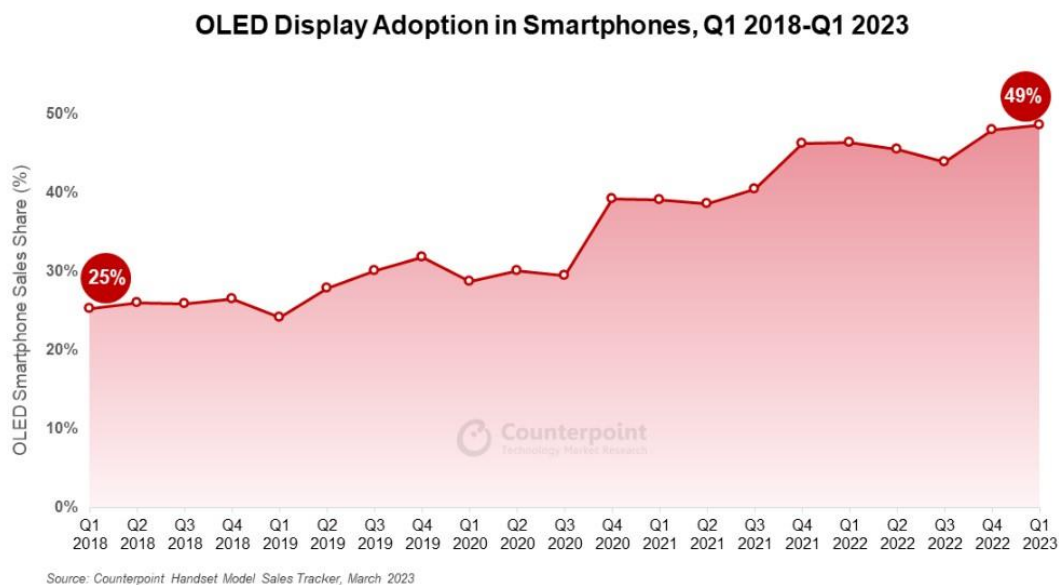
凭借其 foundry 产能和先进封装的基础，中国台湾以 201 亿美元的销售额连续第 13 年成为世界上最大的半导体材料消费地区。中国大陆继续保持强劲的增长，在 2022 年排名第二，而韩国则成为第三大半导体材料消费地区。去年大多数地区都实现了个位数或两位数的高增长。

	2021**	2022	Year-Over-Year
China Taiwan	\$17,715	\$20,129	13.6%
China	\$12,082	\$12,970	7.3%
South Korea	\$12,134	\$12,901	6.33%
Rest of World	\$7,896	\$8,627	9.3%
Japan	\$7,275	\$7,205	-1.0%
North America	\$5,713	\$6,278	9.9%
Europe	\$3,961	\$4,580	15.6%
Total	\$66,776	\$72,691	8.9%

机构：全球智能手机 OLED 面板使用率已达 49%

根据研究机构 Counterpoint 的最新数据，截至 2023 年一季度，全球智能手机使用 OLED 显示面板的比例已达到 49%，创造了历史最高值，高于 2020 年一季度的 29%。

该机构表示，显示屏是消费者购买手机的重要参考因素，OLED 屏有着更好的视角、更深的黑色、更高的亮度，此外通常来说 OLED 面板相比 LCD 也更加省电。统计显示，2023 年一季度，OLED 面板在售价 250 美元以上手机中的占比达到了 94%。



Counterpoint 预计，未来智能手机将越来越多地使用 OLED 屏，新款 iPhone 手机的推出以及折叠屏手机的增长，将加快这一趋势。

【财报速递】

台积电 5 月营收月增 19.4%创 4 个月新高记录

台积电公布 5 月营收，金额为新台币 1,765.37 亿元，较 4 月份增加 19.4%，较 2022 年同期减少 4.9%，为近四个月来新高，也是同期次高记录。累计，2023 年前 5 个月营收 8,330.7 亿元，较 2022 年同期减少 1.9%，登上同期次高成绩。

台积电说明会上预期，第二季营收约为 152-160 亿美元，以 1 美元兑换新台币 30.4 元计算，营收金额来到 4,620.8-4,864 亿元之间。以第二季前两个月合计营收来推测估计，6 月份营收达到 1,380 亿元即可越过财报预测低标。

联电 5 月收入 188 亿元新台币 同比下降 23%

晶圆代工大厂联电公布 2023 年 5 月自结合并营收 188 亿元新台币（单位下同），环比增加 1.7%，同比减少 23%，创今年次高、同期次高。累计前 5 月合并营收 914 亿元，同比减少 17%，仍续创同期次高。

联电先前法说时表示，由于市场需求仍低迷、客户持续库存调整，未见明确复苏迹象，预期第二季晶圆出货量及美元平均售价（ASP）将持稳首季，毛利率估维持 34~36%、稼动率维持约 71~73%，全年资本支出维持 30 亿美元不变。

【产业分析】

机构：先进半导体封装将是新地缘政治战场

据 Yole 集团旗下的 Yole Intelligence 数据，从 2022 年到 2028 年，先进封装市场复合年增长率将达到 10.6%，市值达到 786 亿美元。相比之下，从 2022 年至 2028 年，传统封装市场预计复合年增长率较慢，为 3.2%，到 2028 年底，市值为 575 亿美元。总体而言，封装市场预计将以 6.9% 的复合年增长率增长，市值达到 1360 亿美元。

Yole 集团旗下的 Yole Intelligence 在其最新的 2023 年《先进封装行业现状》年度报告中预测，2022 年先进封装市场约占集成电路封装市场总量的 47%。由于各种大趋势，其份额正在稳步增长。在先进封装市场中，包括 FCBGA 和 FCCSP 在内的倒装芯片平台在 2022 年占据 51% 的市场份额。从 2022 年到 2028 年，预计收入复合年增长率最高的细分市场是 ED、2.5D/3D 和倒装芯片，增长率分别为 30%、19% 和 8.5%。

Bilal Hachemi 博士，Yole 集团旗下 Yole Intelligence 公司半导体、存储器和计算部门的封装技术和市场分析师表示，“2022 年，移动和消费者占整个先进封装市场的 70%。预计从 2022 年到 2028 年，该细分市场复合年增长率为 7%，到 2028 年将占先进封装收入的 61%。电信和基础设施细分部门增长最快，预计收入增长率约为 17%。汽车和交通运输将占市场的 9%，而医疗、工业和航空航天/国防等其他领域将占 3%。”

虽然目前传统封装在晶圆生产中占主导地位，在 2022 年占总产量的近 71%，

但先进封装的市场份额正在逐步增加。

先进封装晶圆的市场份额预计将从 2022 年的约 29% 增长到 2028 年的 37%。就产品数量而言，传统封装占市场份额的 94% 以上，但从 2022 年到 2028 年，先进封装的出货量预计将以 6% 左右的复合年增长率（按销量计算）增长。

Gabriela Pereira, Yole Intelligence 半导体、存储器和计算部门的封装技术和市场分析师表示，“由于芯片短缺和地缘政治紧张局势，包括先进封装在内的半导体价值链受到了关注。各国政府正进行投资，了解和加强国内生态体系。”

中美冲突扰乱了供应链，影响了半导体公司获得芯片和设备的渠道。先进封装是后摩尔定律时代的关键，预计到 2028 年先进封装市场将达到 780 亿美元。然而，贸易紧张带来新供应链并导致生产转移，使供应链多样化，但有可能取代中国的产能。

七家厂商主导先进封装市场，其中 OSAT 占先进封装晶圆的 65.1%。OSAT 扩大了测试专业化程度，而传统的测试公司则投资于封装。随着不同模式的参与者进入封装行业，行业见证了范式的转变，蚕食了 OSAT 的业务。基材供应紧张，影响了材料的可用性，导致交货时间延长和价格上涨。需求减少和产能扩张可能有助于缓解短缺问题。基板供应商投资产能扩张，但有时限制，导致未来 2 到 3 年供应问题持续存在。（来源：集微网）